

Stručný postup zpracování fotorezistu

KOLON ACCUIMAGE řady KP 2100

Skladování: 5-25 °C, 30-60% relativní vlhkosti vzduchu

▼
Odstavný čas: válce fotorezistu by měly mít před laminací teplotu 20-25°C

▼
Laminace: 100-120°C, 0,5 – 1,5 m/min ,tlak 1,5 – 4 bary, výstupní teplota na desce 45-65°C(optimum 48°C pro FR4>1.5 mm, 60°C FR4<1 mm)

▼
Odstavný čas: min. 20 min (ochladnutí), max 72hod ve tmě anebo na certifikovaném žlutém světle, max 21°C

▼
Osvit: čistá měď na 10 stupni 21stupňového klínu (energie 80 mJ/cm2)

▼
Odstavný čas: max .2 měsíce, max. 18°C

▼
Vyvolání: min. 28 s, 0,9-1,3 % Na₂CO₃ nebo K₂CO₃, optimální koncentrace 1% (váhových), vyvolatelnost 0,04-0,15 m2/l
teplota 28-32°C,bod zvratu 55-75% délky vyvolávací komory, oplach 1,5-3 bary
min.30 s při 15-30°C, pH 10,3 -11,3

▼
Leptání: alkalické (do pH 9,4 v oplachovém modulu) i kyselé

▼
Stripování: NaOH nebo KOH, koncentrace 2 – 4% (váhová), organické stripery (RS 111 nebo K.I.V. ST 810,ST 811), koncentrace 5 – 30%, teplota 45 – 55 °C, bod zvratu 40 – 60% délky stripovací komory, oplach 1 – 3 bar min. 20 s

Tloušťka resistu: 38 µm.

Vyrábí: KOLON Industries Inc., Kyunggi-Do, Jižní Korea

Distributor : INTERCONTI, www.inter-conti.cz

Vyrobeno : Semach plošné spoje, www.semach.cz

V případě jakýchkoli potíží nás kontaktujte.